

<<多层印制板制作工艺>>

图书基本信息

书名：<<多层印制板制作工艺>>

13位ISBN编号：9787121142062

10位ISBN编号：7121142066

出版时间：2011-9

出版时间：电子工业出版社

作者：熊建国，莫介云 编

页数：152

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<多层印制板制作工艺>>

内容概要

《多层印制板制作工艺》涉及了电子学、机械工程、流体力学、热动力学、化学、物理学、冶金学和光学等相关领域的专业知识，基本涵盖了印制线路板生产的全过程，它不仅包括了印制线路板的制造、组装和检测，还包括了可靠性和质量检验等方面的知识内容。

《多层印制板制作工艺》分为6章，每章都涵盖了其相关领域的内容，便于阅读理解，每章的内容按照所介绍工艺知识的先后顺序展开。

<<多层印制板制作工艺>>

书籍目录

第1章 绪论 1.1 印制线路的基本知识 1.1.1 初步认识印制线路 1.1.2 印制线路板制造技术发展历史 1.1.3 印制线路板的种类及制造工艺 1.1.4 印制线路制造行业术语 1.2 印制线路的发展 习题 第2章 覆铜板 2.1 覆铜板的介电层 2.1.1 树脂 (Resin) 2.1.2 玻璃纤维 2.2 覆铜板的铜箔 2.2.1 传统铜箔 2.2.2 新型铜箔及其发展方向 2.3 多层板用半固化片 (P.P片) 2.3.1 半固化片性能指标 2.3.2 半固化片的特性与选择 2.3.3 半固化片的存储特性 2.3.4 半固化片的新技术、新品种发展 习题 第3章 生产前的准备工作 3.1 有关PCB板名词的定义 3.2 生产前的准备流程 3.2.1 客户必须提供的数据 3.2.2 资料审查 3.2.3 开始生产前的设计 3.3 印制线路光绘工艺 3.3.1 光绘的数据格式 3.3.2 光绘工艺 3.2.3 暗房处理技术 习题 第4章 多层印制板的制造工艺 4.1 内层制作工艺与检验 4.1.1 内层制作过程 4.1.2 内层检测 4.2 层压工艺 4.2.1 层压流程 4.2.2 各制作过程说明 4.3 数控钻孔工艺 4.4 镀通孔工艺 (孔金属化) 4.4.1 孔金属化制造流程 4.4.2 厚化铜 4.4.3 直接电镀 (Direct-plating) 4.5 外层制作工艺 4.6 二次铜工艺 (线路镀铜、图形电镀) 4.7 蚀刻工艺 4.8 外层检查 4.9 盲/埋孔工艺 习题 第5章 多层印制板表面涂覆工艺 5.1 阻焊工艺 5.2 金手指及喷锡工艺 5.3 其他焊盘表面处理工艺 (护铜剂OSP, 化学镍金) 习题 第6章 多层印制板的成形、最后检验和包装 6.1 成形工艺 6.2 导电性能测试 6.3 最终检验 6.3.1 检查项目 6.3.2 相关标准 6.4 包装工艺 习题 附录A 印制线路板术语中英对照简表 附录B 印制线路词汇参考文献

<<多层印制板制作工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>